

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：

# 江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 305,249,337 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

|          |                        |                          |        |
|----------|------------------------|--------------------------|--------|
| 股票简称     | 捷捷微电                   | 股票代码                     | 300623 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                |                          |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                  | 证券事务代表                   |        |
| 姓名       | 沈欣欣                    | 张家铨                      |        |
| 办公地址     | 江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 | 江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号   |        |
| 传真       | 0513-83220081          | 0513-83220081            |        |
| 电话       | 0513-83228813          | 0513-83228813            |        |
| 电子信箱     | jjmhxx@163.com         | zhangjiaquan1188@163.com |        |

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的 IDM 业务体系。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，分别为：晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片（包括：TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片 Y 电容、压敏电阻等）、二极管器件和芯片（包括：整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET 器件和芯片、碳化硅器件等，主要应用于家用电器、漏电断路器等民用领域，无功补偿装置、电力模块等工业领域，及通讯网络、IT 产品、汽车电子等防雷击和防静电保护领域，保证工业发展和居民生活中电能使用及转换的有效性、稳定性和可控性，并在汽车电子、网络通讯等新兴电子产品中保护昂贵电路，提高产品的安全性，成为新兴市场电子产品品质保证的要素之一。

公司通过了 IATF16949 汽车行业质量体系认证、ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证、OHSAS 18001 职业健康体系认证、QC080000 有害物质过程管理体系认证、UL 安全认证、SGS 环保标准鉴定认证等规定，公司产品符合 UL 电气绝缘性要求、ROHS 环保要求、REACH 化学品注册、评估、许可和限制要求、无卤化等。

#### 一、目前公司主要经营模式：

公司采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，集功率半导体芯片设计、制造、器件设计、封装、测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。

目前，公司具体经营模式如下：

#### （1）采购模式

公司物资管理部负责公司的原材料、辅助生产材料的采购，具体采购程序如下：

①根据采购计划对采购产品进行分类

②采购信息的编制和确定

物资管理部根据《采购计划单》编制《采购合同》，主要原材料采购文件应包括拟采购产品必要的信息。如有必要，物资采购部应请相关技术、品质管理部参与采购要求和规范的制定，或与供方共同制定采购要求和规范，以便利用供方专业知识使公司获益。

③采购的执行

物资管理部根据经批准的《采购合同》，在《合格供方名录》的供方范围内进行采购。采购通常以与供方签订供货合同的方式进行，以明确采购产品的价格、交货期限、技术标准、验收条件、质量要求、违约责任等相关内容；

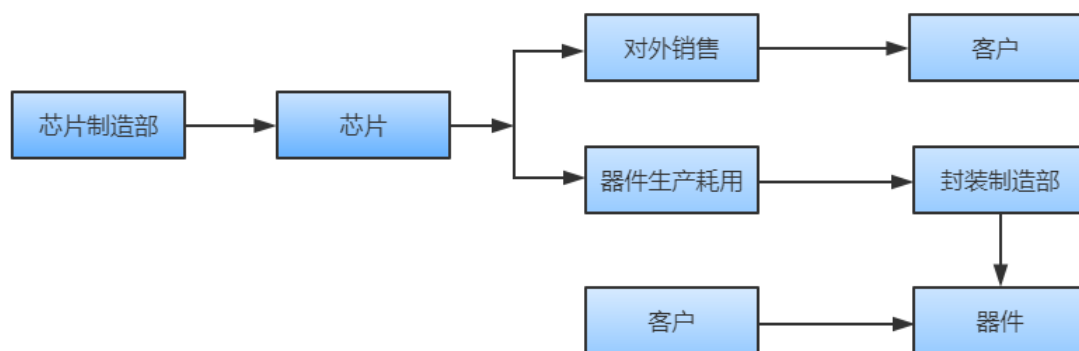
对于长年供货的供方，物资管理部在以合同的方式向供方明确采购产品的技术标准、验收条件、质量要求、违约责任等相关内容后，可以采用传真购货或口头通知的方式进行具体的采购；物资管理部应及时跟踪采购进度，反馈给相关部门。

④采购产品的验证

物资管理部应协调采购产品的验证活动；当公司或公司客户提出在供方的现场实地验证时物资管理部应在采购信息中对需要在供应商现场开展验证的安排作出规定；采购产品到达公司后，材料仓库进行登记并存放于待检区，报相关技术、品质管理部进行检验；与供应商签订的技术协议应交品质管理部进行审核，品质管理部负责技术协议文件的管理和发放，确保公司使用的技术协议是现行有效的。

(2) 生产模式

公司根据销售订单要求，制定生产计划，由技术管理部制定工艺卡、作业指导书和检验规程，交给生产人员在生产中参照执行。公司生产部门分为芯片制造部和封装制造部，生产模式如下：



①生产计划和任务单

芯片制造部/封装制造部根据产品要求评审的结果，考虑库存情况，并结合公司的生产能力，制定《生产计划单》；芯片制造部/封装制造部根据《生产计划单》，组织下达《随工单》安排生产；

②设备工程部负责按《设备管理控制程序》的规定做好生产设备的管理、维护和保养工作。

③生产过程控制

A. 技术管理部负责编制适宜让生产员工清楚理解的工艺卡、作业指导书和检验规程；

B. 芯片制造部/封装制造部组织和监督操作者严格依据文件的要求进行操作，做好自检和互检要求的记录；

C. 质量管理部根据《产品的监视和测量控制程序》的要求进行产品检验，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的要求对异常现场进行整改和预防。

(3) 营销模式

公司产品销售分为直销和经销。其中，功率半导体器件以直销模式为主，直销占比在70%以上，防护器件以直销和经销相结合。

①营销理念

公司的营销理念为：建立售前、售中、售后一体的市场营销团队，发展知名品牌客户和优质渠道商，与客户形成战略合作，树立公司国际品牌形象，提高市场占有率。

②营销方式

公司产品应用的市场领域较多，产品规格多，且对产品性能要求各异。公司既销售公司通用规格的产品，也可以根据客户的诉求为其设计、生产定制化产品，并可对客户全方位的技术服务。具体销售流程如下：

A. 公司销售人员与客户进行初步沟通，了解客户的产品用途、需求、用量、付款条件等信息，及已有

产品不足之处或预期产品需要达到的最佳效果，为客户提供选型服务或建议，与客户建立初步合作关系；

B. 如客户有特殊要求，销售人员应与应用工程师或其他部门工程师共同评估公司产品是否满足客户的要求，并选择合适的产品型号；

C. 销售人员和区域销售经理评估客户信誉状况，选择合作模式，后续按照此模式逐步推进合作；

D. 销售人员提供给客户相应产品的规格书，向客户介绍公司产品特点、性能指标，帮助客户认识、了解公司的产品及性能，并听取客户进一步的意见；

E. 根据进度安排，销售人员准备好选型的样品提供给客户，及时跟进客户的试验情况，与客户沟通解决试验中遇到的问题，最终达到客户要求的理想效果；

F. 针对有特殊要求的客户，如其用量较大或其应用具有领域代表性，公司可为其设计、生产定制化产品，定制化产品销售流程如下：

a. 销售人员了解客户的产品特殊要求、产品应用领域、时间进度表、需求量、目标价格、付款条件等信息，填写《定制产品需求单》，交由区域经理或市场营销部正/副部长审核评估；

b. 市场营销部将《定制产品需求单》送交相关技术部门和品质管理部，品质管理部组织各部门对定制产品的市场潜力、产品性能以及公司的生产能力、物料物资、资金情况等进行评估，将评估结果向总经理汇报，由总经理作出最终批示；

c. 根据总经理同意生产定制产品的批示，市场营销部与客户签订定制产品加工合同；各部门按照分工开始生产样品，样品完成后，由相关技术部门完成产品的考核和试验；

d. 样品达到预期的性能指标后将该样品的试验结果和样品提供给客户进行产品试验，及时跟进客户的试验情况，改善产品性能并重新送样，最终满足客户要求的理想效果；

e. 根据客户定制产品的试验、生产情况，公司各部门对定制产品进行总结，确定是否将定制产品纳入公司标准产品的量产计划中。

#### (4) 盈利模式

功率半导体芯片的设计制造能力是公司的核心竞争力，是公司可持续盈利及发展的基础。公司多项功率半导体芯片和封装器件的先进技术不仅保证公司生产工艺领先、标准产品质量可靠，还能够按照客户提出的个性化需求设计、调整功率半导体芯片和封装器件的生产工艺，生产定制产品，及时满足终端产品在电能转换与控制、保护高端电子产品昂贵电路等方面的技术升级。同时，公司参与到客户的生产经营中，通过分析整理客户在产品结构调整、品质提升过程中的技术瓶颈，有针对性地研发新技术，改进生产工艺，并根据下游行业的发展趋势调整自身产品结构，经公司技术、市场、生产、财务、管理各部门共同严格论证后，将确定未来有广泛市场需求的定制产品转化为公司常规产品生产，最大程度地确保公司产品响应客户和行业发展的需要。

公司为客户定制产品不仅体现了公司研发创新的技术实力，也表现出公司与客户实现双赢的营销能力，因此，公司产品深受下游客户认可，品牌知名度和美誉度不断提升，客户结构正向大型化、国际化方向发展，同时，产品市场结构不断延伸，在保持传统家电市场、工业类市场优势地位的同时，正逐步进入航天、汽车电子、IT产品等新兴市场。

#### (5) 管理模式

在长期经营发展中，公司建立了符合公司自身经营特点和发展方式的管理模式，设置合理的职能部门，在公司董事会制定的经营路线下，坚持公开、透明地执行各项公司制度和计划，协调各部门之间有效配合，形成了较高的管理效率。

半导体行业是技术密集型行业，公司重视研发管理，根据公司现有和未来产品系列分别设立研发项目组，有针对性地研发新产品和新技术，最大程度地保证公司的研发效率和研发成果转化率，不断提高市场竞争力和盈利能力。同时，公司不断吸收引进先进人才，通过激励措施和实践培养，为公司未来发展储备技术、营销、采购等方面的管理人才。

### 二、目前公司主要产品系列及用途：

#### 1、晶闸管系列：

晶闸管（又称：可控硅）耐压高、电流大，主要用于电能变换与控制。即直接对交流电的输出大小进行控制。通过控制晶闸管的触发时间来实现交流电的开通，通过交流电的过零来实现关断，从而实现对输出电能大小的控制。可以用微小的信号功率对大功率的电流进行控制和变换，具有体积小、重量轻、耐压高、容量大、效率高、控制灵敏、使用寿命长等优点。晶闸管的功用不仅是整流，还可以用作无触点开关以快速接通或切断电流等。晶闸管的出现，使半导体技术从弱电领域进入了强电领域，成为工业、交通运输、军事科研以至商业、民用电器等方面广泛采用的电子元器件。

#### 2、防护器件系列：

半导体防护器件种类较多，主要有半导体放电管（TSS）、瞬态抑制二极管（TVS）、静电防护元、器件（ESD）、集成防护器件、Y电容、压敏电阻等，可应用于仪器仪表、工业控制、汽车电子、手持终端设备、户外安防、电脑主机等各类需要防浪涌冲击、防静电的电子产品内部，保护内部昂贵的电子电路。由于使用场合广泛，市场需求量较大，半导体防护器件市场规模较为稳定。

### 3、二极管系列：

二极管是最常用的电子器件之一，二极管的单向导电特性可以把正弦波的交流电转变为脉动的直流电。用途广泛，几乎所有的电路中都有使用到。公司二极管芯片采用SIPOS+GPP钝化工艺，具有高可靠性，三种金属组合供客户选择，主要产品有高耐压整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管、整流二极管模块组件等，用于民用电源整流、工业设备电源整流、漏电断路器、电表、通讯电源、变频器等应用领域。

### 4、MOSFET系列：

MOSFET，金属-氧化物半导体场效应晶体管，一种全控制型半导体功率分立器件，通过栅极电压的变化来控制输出电流的大小，并实现开通和关断，输入阻抗大、导通电阻小、功耗低、漏电小、工作频率高，工艺基本成熟，是市场规模最大的功率分立器件。应用极其广泛，主要包括电源类和驱动控制类两大类应用。公司MOSFET系列产品主要包括中低压沟槽MOSFET产品、中低压分离栅MOSFET产品、中高压平面VDMOS产品以及超结MOS等产品。

### 5、厚模组件：

厚模组件系列产品采用，模块集成封装，把可控硅、二极管、MOSFET、IGBT、FRD等芯片组合成不同的电路拓扑结构；在模块基础上集成控制线路，衍生出了固态继电器、智能模块及IPM等功能模块，主要应用于调温系统、调光系统、调速等系统；具体应用于软启动、变频器、无功补偿领域。

### 6、碳化硅器件：

碳化硅肖特基二极管是碳化硅器件之一，具有超快的开关速度，超低的开关损耗，正向压降(Vf)为温度特性，易于并联，可承受更高耐压和更大的浪涌电流，用于电动汽车、消费类电子、新能源、轨道交通等领域，主要产品为塑封碳化硅肖特基二极管器件。

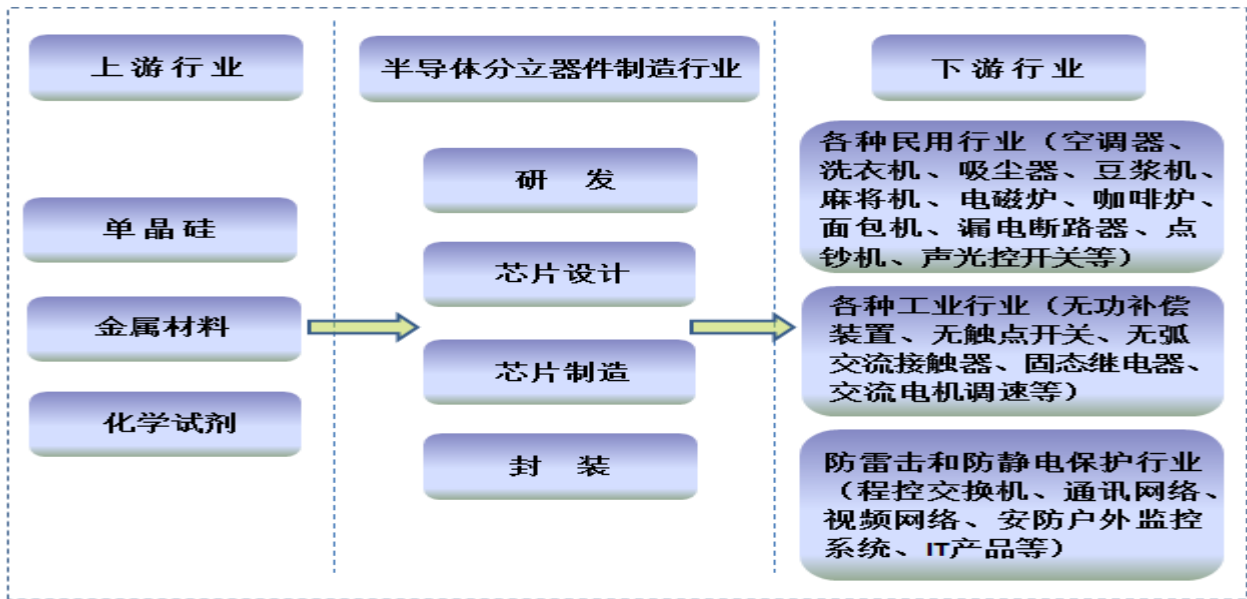
### 7、其他：

功率型开关晶体管及达林顿晶体管，应用于点火器、磁电机等领域，具有良好的可靠性和质量。

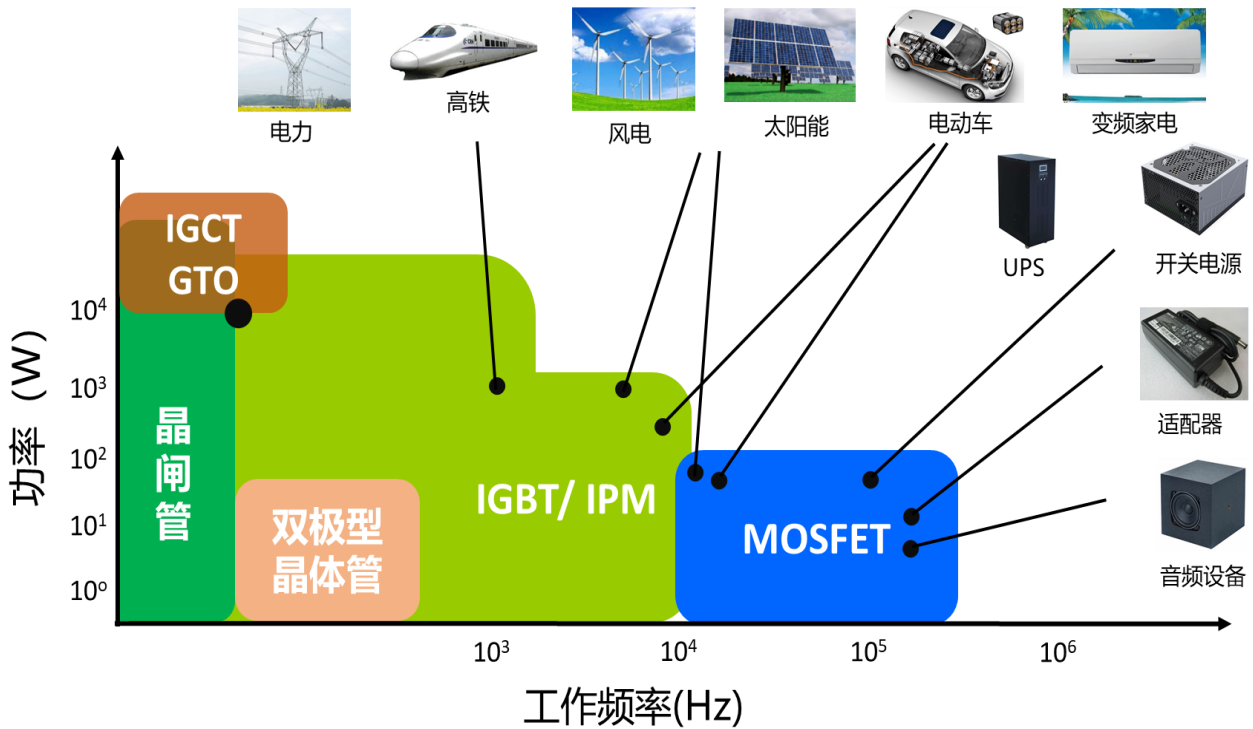
（二）公司产品主要类别图示：



（三）公司产品主要用途图示：



(四) 半导体各功率分立器件的特性及其应用:



资料来源: Yole, 中银证券

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位: 元

|                        | 2019 年         | 2018 年         | 本年比上年增减 | 2017 年         |
|------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 营业收入                   | 673,997,139.35 | 537,470,873.08 | 25.40%  | 430,806,893.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 189,686,002.12 | 165,668,690.94 | 14.50%  | 144,149,073.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 182,561,463.81 | 152,690,859.49 | 19.56%  | 138,542,007.97 |

|               |                  |                  |               |                  |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,399,905.99   | 261,393,334.61   | -23.72%       | 122,987,218.88   |
| 基本每股收益（元/股）   | 0.70             | 0.62             | 12.9%         | 0.58             |
| 稀释每股收益（元/股）   | 0.70             | 0.62             | 12.9%         | 0.58             |
| 加权平均净资产收益率    | 13.32%           | 12.86%           | 0.46%         | 14.29%           |
|               | 2019 年末          | 2018 年末          | 本年末比上年末增<br>减 | 2017 年末          |
| 资产总额          | 2,455,151,023.78 | 1,560,565,948.20 | 57.32%        | 1,361,347,756.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,245,937,201.96 | 1,350,276,466.45 | 66.33%        | 1,220,652,715.74 |

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

|                            |                |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
| 营业收入                       | 123,478,451.44 | 162,927,174.00 | 178,709,916.86 | 208,881,597.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 34,455,445.98  | 50,875,731.11  | 50,266,373.09  | 54,088,451.94  |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 33,786,379.78  | 49,841,706.87  | 46,990,268.33  | 51,943,108.83  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 29,337,884.89  | 65,809,403.77  | 58,718,838.90  | 45,533,778.43  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普<br>通股股东总<br>数                                           | 25,421      | 年度报告披<br>露日前一个<br>月末普通股<br>股东总数 | 29,689     | 报告期末表<br>决权恢复的<br>优先股股东<br>总数 | 0       | 年度报告披<br>露日前一个<br>月末表决权<br>恢复的优先<br>股股东总数 | 0 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况                                                  |             |                                 |            |                               |         |                                           |   |
| 股东名称                                                          | 股东性质        | 持股比例                            | 持股数量       | 持有有限售条件的股份<br>数量              | 质押或冻结情况 |                                           |   |
|                                                               |             |                                 |            |                               | 股份状态    | 数量                                        |   |
| 江苏捷捷投<br>资有限公司                                                | 境内非国<br>有法人 | 31.72%                          | 85,500,000 | 85,500,000                    |         |                                           |   |
| 黄善兵                                                           | 境内自然<br>人   | 10.15%                          | 27,360,000 | 27,360,000                    |         |                                           |   |
| 南通中创投<br>资管理有限<br>公司                                          | 境内非国<br>有法人 | 7.19%                           | 19,380,000 | 0                             |         |                                           |   |
| 王成森                                                           | 境内自然<br>人   | 5.07%                           | 13,680,000 | 10,260,000                    |         |                                           |   |
| 张祖蕾                                                           | 境内自然<br>人   | 3.23%                           | 8,704,170  | 8,550,000                     |         |                                           |   |
| 沈欣欣                                                           | 境内自然<br>人   | 3.17%                           | 8,550,000  | 6,412,500                     | 质押      | 630,000                                   |   |
| 南通蓉俊投<br>资管理有限<br>公司                                          | 境内非国<br>有法人 | 2.54%                           | 6,840,000  | 6,840,000                     |         |                                           |   |
| #苏颜翔                                                          | 境内自然<br>人   | 0.42%                           | 1,137,300  | 0                             |         |                                           |   |
| 中国银行股<br>份有限公司<br>— 国泰 CES<br>半导体行业<br>交易型开放<br>式指数证券<br>投资基金 | 其他          | 0.36%                           | 976,950    | 0                             |         |                                           |   |
| 薛治祥                                                           | 境内自然<br>人   | 0.36%                           | 961,875    | 961,875                       |         |                                           |   |

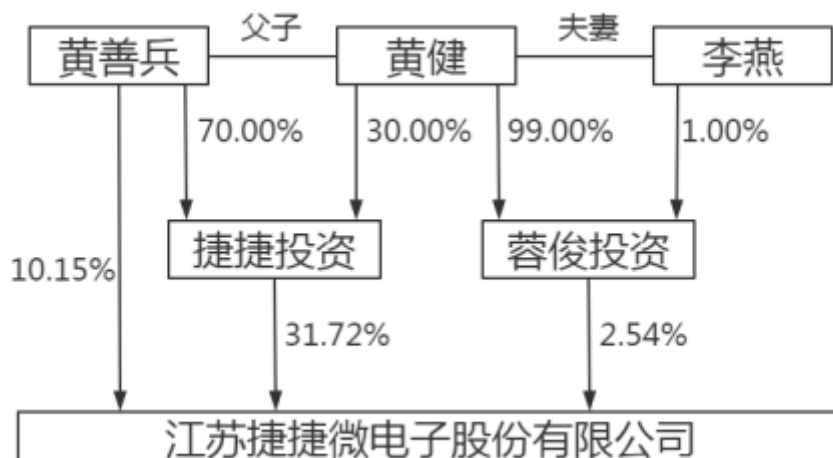
|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏捷捷投资有限公司、南通蓉俊投资管理有限公司与黄善兵为一致行动人，南通中创投资管理有限公司与张祖蕾为一致行动人。 |
|------------------|-----------------------------------------------------------|

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 三、经营情况讨论与分析

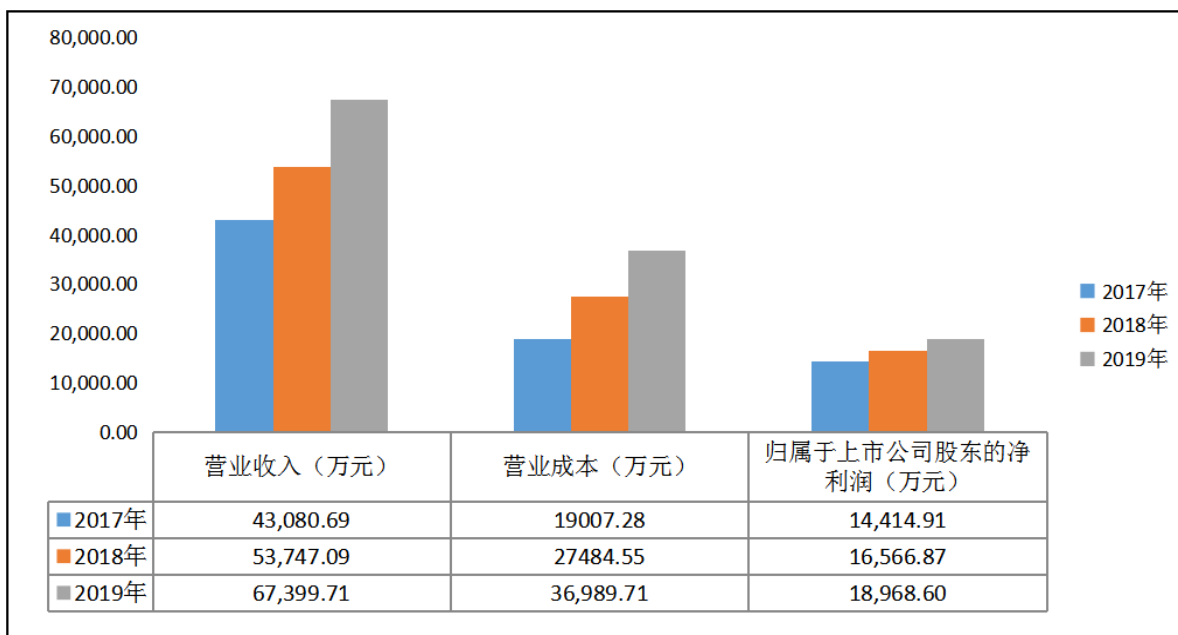
## 1、报告期经营情况简介

报告期内，在全体员工的共同努力下，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚持国产替代进口，坚决贯彻公司发展战略要求，积极推动重点项目的建设，加速推进重点工作的开展，坚定不移地在功率半导体器件领域内可持续发展，公司的核心竞争力显著提升，细分行业领先地位进一步巩固，主营业务实现了较快增长。

公司在中美贸易战及中国半导体产业亟需国产替代进口和提升国产化率的机遇与挑战下，公司快速启动并实施定增项目布局 MOSFET、IGBT 及第三代半导体器件等广阔市场新领域。公司围绕主营业务，以内生增长为主，通过募投项目和定增项目的建设，存量与增量并存，并结合公司一以贯之的定制化生产和个性化服务等实现国产替代进口，提升市场份额与品牌影响力，深耕于功率半导体领域，做优做强，保持企业健康、稳定、可持续发展。

报告期内，公司实现营业总收入 67,399.71 万元，较上年增长了 25.4%，归属于上市公司股东的净利润为 18,968.6,0 万元，较上年增长了 14.50%。

截至2019年12月31日，公司资产总额245,515.10万元，比年初增加89,458.51万元，增长57.32%，归属于上市公司股东的净资产224,593.72万元，比年初增加89,566.07万元，增长66.33%。



2019年度，公司重点工作的执行情况概述如下：

1、再融资方面，2019年9月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。2019年11月28日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2019]2289号核准批复。经中国证监会核准，非公开发行A股股票35,660,997股。本次非公开发行股票于2020年1月8日上市。本次非公开发行股票事项完成后，公司股份总数由269,588,340股变更为305,249,337股。

2、项目建设方面，由公司全资子公司捷捷半导体有限公司承建的非公开发行募集资金项目“新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线”正在有序的推进中，已在2018年3月开工建设，基础设施及配套基本完成，计划在2021年实现产能利用。公司承建的非公开发行募集资金项目“电力电子器件封测生产线”的项目已于2018年10月开工建设，目前厂房已基本建设完毕，已于2019年底开始正式生产。

3、员工激励方面，公司2017年限制性股票激励计划中2名激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2019年3月28日完成。2019年4月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2019年5月8日，公司已为本次符合解除限售条件的86名激励对象办理完成解除限售的事宜，合计解除限售780,102股限制性股票。

4、利润分配方面，2019年3月20日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度利润分配预案》，以总股本179,725,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至269,588,340股。剩余未分配利润结转至下年。该利润分配预案已于2019年4月10日实施完毕，本公司总股本269,588,340股。



5、重大投资方面，2019 年 11 月 25 日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金在上海临港新片区设立控股子公司，公司与上海芯马信息科技有限公司（有限合伙）、南通捷成信息科技有限公司（有限合伙）三方共同出资人民币 2,000 万元成立“捷捷微电（上海）科技有限公司”。2019 年 2 月 26 日，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 1000 万元人民币在中国深圳设立全资子公司，公司出资比例为 100%。

6、科研方面，公司历来十分重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，报告期内，公司把握市场趋势，各项产品研发项目均有有条不紊的进行。截至 2019 年 12 月 31 日获得授权专利 82 件，其中：发明专利 18 项，实用型新专利 63 项，外观专利 1 项。已受理发明专利 49 项，受理 PCT 专利 1 项，受理实用新型专利 13 项。其中：捷捷微电子获得授权专利 48 项，其中发明专利 16 项、实用新型专利 32 项。申请受理专利共计 20 件，其中：发明专利 16 件，PCT1 件，实用新型专利 3 项。其中：捷捷半导体截至 19 年 12 月 31 日获得授权专利 34 项，其中发明专利 2 项、实用新型专利 31 项、外观专利 1 项。申请受理专利共计 43 件，其中：发明专利 33 件，实用新型专利 10 项。

7、公司治理方面，公司严格按照相关规定规范管理，积极健全并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式与投资者进行交流互动，保证投资者与上市公司交流的畅通。

## 2、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业发展趋势

#### 1、国家政策全力支持，未来发展可期

功率半导体关系到我国智能电网、高铁动力系统、汽车动力系统等关键零部件的国产化进程，是关系到高铁工业、汽车工业自主可控的战略性新兴产业。国家政策的支持将加速我国高端功率器件的发展进程，加速 MOSFET、IGBT 等高端功率器件芯片生产工艺的研制和开发进程。半导体产业依托“十三五”国家战略性新兴产业发展规划和十九大提出“资本为实体经济服务”的精神，未来发展可期。

2010 年以来，国务院及各部委陆续颁布了鼓励半导体行业发展的政策，具体如下表所示：

| 时间      | 部门      | 政策名称                  | 相关内容                                                                |
|---------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2010.1  | 国务院     | 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 | 着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业                                     |
| 2012.07 | 国务院     | 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》  | 突破先进和特色芯片制造工艺技术、先进封装、测试技术以及关键设备、仪器、材料核心技术，培育集成电路产业竞争新优势             |
| 2013.02 | 国家发改委   | 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》  | 将集成电路测试设备纳入战略性新兴产业重点产品目录                                            |
| 2014.06 | 国务院     | 《国家集成电路产业发展推进纲要》      | 以设计为龙头、制造为基础、装备和材料为支撑，以技术创新、模式创新和体制机制创新为动力，推动集成电路产业重点突破和整体提升，实现跨越发展 |
| 2014.1  | 发改委, 财政 | 《国家集成电路产业投            | 将重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、                                              |

|         | 部            | 资基金》                         | 封装测试、设备和材料等产业                                                                                                  |
|---------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015.03 | 财政部          | 财税(2015)6号：鼓励集成电路产业发展企业所得税政策 | 符合条件的企业自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止                                               |
| 2016.01 | 科技部、财政部、税务总局 | 《2016年国家重点支持的高新技术领域目录》       | 将大功率半导体器件纳入《2016年国家重点支持的高新技术领域目录》                                                                              |
| 2016.11 | 国务院          | 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》         | 明确着力提升核心基础硬件供给能力。提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片。                                                                        |
| 2016.11 | 国务院          | 《我国集成电路产业“十三五”发展规划建议》        | 到2020年全行业销售收入达到9300亿元；16/14nm制造工艺实现规模量产，封装测试技术进入全球第一梯队                                                         |
| 2018.7  | 工信部、发改委      | 《扩大和升级信息消费三年行动（2018-2020年）》  | 主要目标是促进信息消费规模的显著增长，到2020年，预计信息消费达到6万亿元，年均增长11%以上。2019年6月正式宣布向运营商发放5G牌照，这给分立器件行业家用电器、网络通信、物联网以及5G基站等领域的发展增添新的动能 |
| 2020.3  | 工信部          | 《关于推动5G加快发展的通知》              | 明确提出加快5G网络建设部署、丰富5G技术应用场景、持续加大5G技术研发力度、着力构建5G安全保障体系、加强组织实施等五方面18项措施。                                           |

国家半导体产业政策的技术导向和扶持对公司经营形成了良好的发展环境，鼓励本土企业在拥有自主知识产权的基础上，与国际产品形成良性竞争，降低我国对进口功率半导体分立器件的依赖性。在国家政策强有力的支持下，中长期来看，我国必然会出现若干家跻身国际一线梯队的功率半导体企业，而公司也将会在国家政策强有力的支持下，朝上述目标而努力。

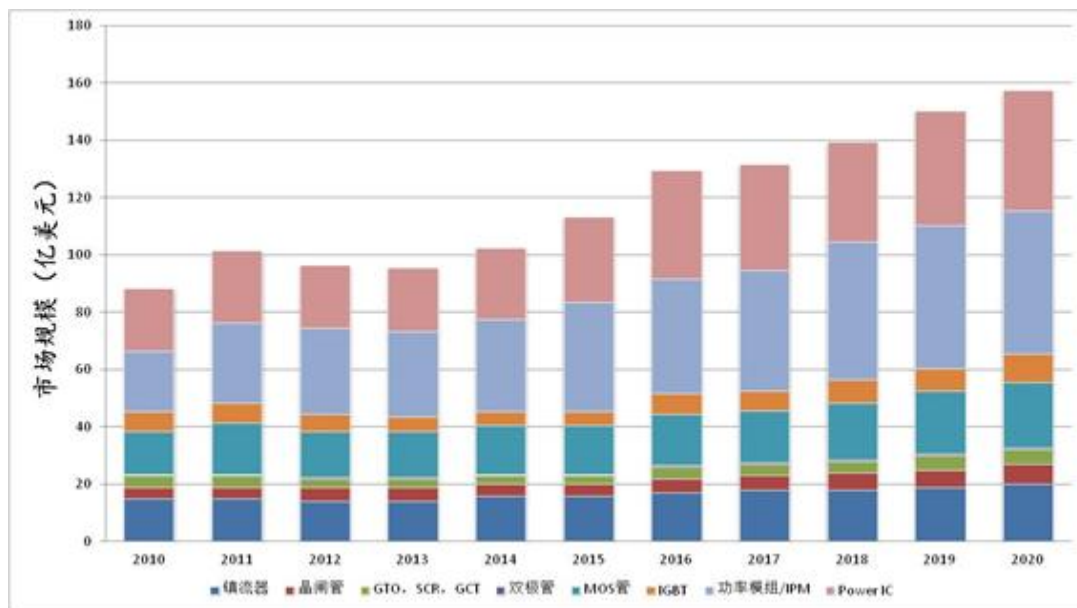
## 2、半导体分立器件市场前景广阔

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计数据显示，根据 WSTS 统计，从 2013 年到 2018 年，全球半导体市场规模从 3,056 亿美元迅速提升至 4,688 亿美元，年均复合增长率达到 8.93%。

我国半导体分立器件的起步虽然较晚，但是市场规模增长迅速，已经成为全球最大的功率半导体市场之一，预计未来我国半导体分立器件销售额仍保持增长态势。根据中国半导体行业协会统计，2018 年功率半导体市场规模增长至 2,591 亿元，增长率为 12.76%，2019 年市场规模预计增加至 2,900 亿元，硅基功率器件是市场主流产品。2019 年是我国 5G 元年，但网络覆盖不完善、终端数量较少、终端价格昂贵，随着网络建设的逐渐完善、终端机型数量增加和价格下降，2020 年将可能迎来 5G 消费的爆发。

根据盖世汽车研究院预测，汽车电子的广阔市场，2017 年-2022 年我国汽车电子市场将以 10.6% 速度增长，增速超过全球，2020 年我国汽车电子市场规模将超过 8,000 亿元。

功率半导体器件作为中国发展信息化及网络强国的核心器件，未来将迎来新一轮的发展阶段，未来三年，预计中国电力电子器件市场规模复合增长率高达 9.7%，整体销售规模将进一步提高。预计 2020 年全球功率半导体市场规模近 160 亿美元。



2010-2020 功率半导体市场规模 资料来源: Yole

受益于计算机、通信、消费电子等终端市场需求的拉动，在我国以物联网、轨道交通、节能环保、新能源汽车等产业为代表的战略性新兴下游应用市场的发展推动下，我国目前已成为全球最大的半导体分立器件应用市场，并保持着持续、快速、稳定的发展。

### 3、半导体分立器件国产供给率低，国产替代化道路任重而道远

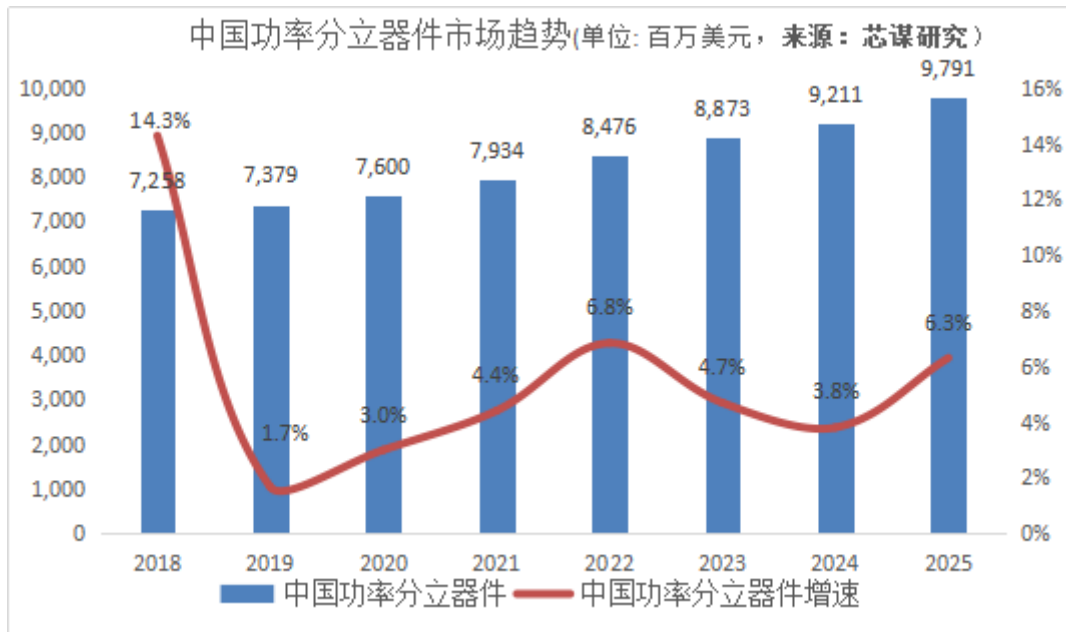
根据海关统计数据，2018 年中国半导体进出口金额为 3,414.6 亿美元，出口金额为 1,140.1 亿美元，进出口逆差为 2,274.5 亿美元。而 2015 年中国集成电路（IC）进口金额已超过原油，成为我国第一大进口商品。2018 年中国集成电路（IC）进口金额为 3,120.6 亿美元，而出口金额仅为 846.4 亿美元，进出口逆差 2,274.2 亿美元。特别是 2018 年由于国际贸易摩擦，美国对中兴公司的制裁使得其一度停摆。尽快提高半导体产品的国产化供给率，目前成为了我们国家的工业现代化进程中亟需重视及解决的关键问题。

在半导体分立器件行业，尽管中国已经发展成为全球最大的半导体分立器件市场，但就半导体分立器件的供给而言，目前全球半导体分立器件主要以美日欧企业为主，高端市场几乎被这三大主力垄断。中国功率半导体分立器件的设计制造能力还有待提高，关键技术仍掌握在少数国外公司手中。

全球功率市场主要竞争者包括德国英飞凌(Infineon)、意法半导体（ST）、恩智浦半导体（NXP）、赛米控(Semikron)、日本三菱（Mitsubishi）、瑞萨（RENESAS）、富士电机（Fuji Electric）、美国安森美（On Semi）、瑞士 ABB 等，占市场份额达达到 70%以上。其中，在 1700V 电压以上的工业 IGBT 市场，德国英飞凌（Infineon）、三菱、ABB 公司处于行业领先地位，且几乎垄断了 3300V 以上高压 IGBT 产品。富士电机（Fuji Electric）、赛米控(Semikron)和美国安森美(On Semi)的主场是 1700V 以下的消费级和汽车级 IGBT 市场。

目前，国内市场所需的功率半导体分立器件主要依赖进口产品，国际大型半导体公司产品在中国市场的优势地位突出。据芯谋研究数据统计，2019 年，虽然贸易摩擦持续进行，以及全球半导体产业因为存储

器产业下滑而下降，但全球功率分立器件产业仍然微小幅度增长。2020 年，因为新冠肺炎的爆发，以及在全球的蔓延，将直接影响中国和全球半导体产业的恢复和增长，目前预期全球功率分立器件产业小幅成长。未来几年，以及为应对新冠肺炎带来的经济下行压力，预计国家将加快 5G 网络建设与推广、推出较优惠的电动汽车消费政策、持续的产业升级，以及国家的互联网+等战略推动下，在各种工业电子产品、高能效的家用电器的带动下，中国功率分立器件将会恢复成长。近年来，国内企业生产技术快速追赶，部分优质公司已跻身行业第二梯队。虽然在高端产品领域，国内企业的技术与国外仍有差距，晶闸管等细分行业在我国发展成熟，国内部分优质企业的技术已达到国际水准，将迎来新的增速。



公司作为国内晶闸管行业的龙头企业，在与国外大型半导体企业竞争的过程中，取得了一定的市场地位。晶闸管是功率半导体分立器件中技术成熟的产品，在所有功率半导体分立器件中，晶闸管耐压容量最高（可达 12KV 以上）、电流容量最大（可到 6000A 以上）。正是由于其高电压、大电流、导通损耗极低的特性，在高压直流输电（HVDC）、静止无功补偿（SVC）、大功率直流电源及超大功率和高压变频调速应用方面占有十分重要的地位。另一方面，相对于其他功率半导体分立器件，晶闸管制造成本较低、体积小、重量轻、相应配套电路结构简单的特点，保证了晶闸管的广泛应用空间。

公司凭借长期的技术积累和自主创新，生产的高端晶闸管产品逐渐受到国际知名半导体公司和下游知名企业的重视和认可，通过了复杂的产品技术、生产工艺等前期质量认定程序，原来只采用国际晶闸管产品的下游客户以及国际知名半导体公司逐步与公司达成供货意向或签署了供货协议，实现国产高端产品替代进口同类产品，降低我国对国际大型半导体公司的依赖，并不断增加高端晶闸管产品的出口量，在国际市场上以优良的性价比优势与国际产品展开良性竞争。

#### 4、“十三五”发展机遇为行业提供新增长点

2016 年，科技部、财政部、税务总局公布了《2016 年国家重点支持的高新技术领域目录》，将大功率半导体器件纳入本目录，具体包括：高可靠、长寿命、低成本 VDMOS 垂直栅场效应晶体管制造技术；绝缘

栅双极型功率管（IGBT）；用于大型电力电子成套装置的集成门极换流晶闸管（IGCT）制造技术；其他新机理的大功率半导体器件制造技术。

2016 年，国务院出台《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确指出做强信息技术核心产业，提升核心基础硬件供给能力。推动电子器件变革性升级换代，加强低功耗高性能新原理硅基器件、硅基光电子、混合光电子、微波光电子等领域前沿技术和器件研发，功率半导体分立器件产业将迎来新一轮高速发展期。

2017 年 1 月，国家发改委公布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》（2017 年第 1 号），涉及电子核心产业，进一步明确电力电子功率器件的地位和范围，包括金属氧化物半导体场效应管（MOSFET）、绝缘栅双极晶体管芯片（IGBT）及模块、快恢复二极管（FRD）、垂直双扩散金属-氧化物场效应晶体管（VDMOS）、可控硅（SCR）、5 英寸以上大功率晶闸管（GTO）、集成门极换流晶闸管（IGCT）、中小功率智能模块。

公司以“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、《国家集成电路产业发展纲要》为牵引，聚焦主业发展方向，通过主营业务的聚焦和深耕，结合资本市场，着力培育公司新的增长点，积极布局相应的 MOSFET、IGBT 及第三代半导体器件，拓宽现有产业链，在功率半导体分立器件行业的高速发展期引领行业前进，在广阔的市场空间中占有一席之地。

## （二）公司发展战略与规划

### 1、提升产品的优势地位，紧随科技进步扩展产业链

#### （1）发展愿景：

公司成为具有国际竞争力的功率半导体器件品牌制造商，坚守并秉承向顾客提供优质产品与解决方案，为股东创造价值，让员工分享企业发展成果，承担企业社会责任与使命，建立“诚信、务实、创新、共赢”的企业价值观。

#### （2）发展纲要：

公司以“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、《国家集成电路产业发展纲要》等为指引，聚焦主业发展方向，基于顾客价值创造，正确认知与选择，砥砺创造与创新，保持对研发和创新的高投入，用面向未来的能力来提升自己，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚持以质量为主要竞争优势，矢志不渝地深耕功率半导体器件领域，实现高质量可持续发展。

#### （3）发展规划：

1) 坚持以市场为导向，以平台和品牌为引擎，技术立足，创新引领，细分、优化、拓展业务板块，打造优秀团队和高效的组织架构与营运机制，提升产品应用领域与转型升级，提高创造现金流的能力，保证可持续的现金流。

2) 加强产线与产能和产品规划, 推动可控硅 (IDM)、二极管芯片及器件和 FRD (IDM)、MOSFET (Fabless+封测→IDM)、IGBT (Fabless+封测→IDM)、光电耦合器件 (Fabless+封测→IDM)、汽车用半导体功率器件 (IDM) 等以及碳化硅、氮化镓等新型电力半导体器件的研发和推广。

3) 建立健全长效激励机制, 以上年度实现的净利润值或完成当年关键业绩指标为基准考核对下年度实现的超额部分实行薪酬激励与股权激励双轨制, 即根据上年度实现的超额 (税后净利) 部分的 20-30% 或 30-50% 用于团队的薪酬激励和股权激励 (可供团队自主选择)。

4) 完善并改进现有的经营理念与经营模式, 着力提升市场维度与格局, 实现人才与平台, 市场与品牌的友好结合, 以“产线、产品、市场”和“市场、产品、产线”的双驱动, 全面融合深圳、上海、成都、西安、杭州等地的人才、资源和市场为中心的布局, 拓展与拓宽产业链, 放眼未来, 未来可期。

5) 加强公司治理结构, 服从市场原则, 紧紧围绕主业, 通过产业基金与并购基金等方式, 围绕技术与业务协同实现产业整合与并购重组, 预期明确, 风险可控, 商誉保证。严守每股收益和净资产收益率的双底线, 提高公司核心竞争力, 提升公司价值与股东价值。

## 2、增强公司综合竞争力, 提升公司的行业地位

### (1) 行业及市场定位与规划:

1) 致力于功率半导体器件的设计、制造和销售, 聚焦进口替代, 打造具有国际竞争力的一流产品线, 不断提升国内国际市场影响力。

2) 进一步拓展“方片式”塑封晶闸管器件在家用电器、低压电器、工业设备等领域的市场份额, 在细分领域力争国内领先、世界一流, 努力打造成为国际市场知名品牌。

3) 进一步拓展功率半导体防护器件在通讯设备、汽车电子、智能家居、安防、工业控制、仪器仪表、照明、移动终端设备、防雷模块等领域的应用, 冲刺国内领先。

4) 积极布局有特色的 FRD、高端整流器产品线, 进入新能源汽车、光伏、风电、电焊机、各类变频电源等领域。

5) 加快功率 MOSFET、IGBT、碳化硅、氮化镓等新型电力半导体器件的研发和推广, 从先进封装、芯片设计等多方面同步切入, 进入新能源汽车、5G、手机快充、平板电脑、智能监控和各类电源等领域。

6) 积极推进研发投入, 持续精益制造技术和制造工艺, 保持产品具有良好温度特性的产品结构和工艺技术; 具有较高的  $dv/dt$  能力、较强的抗电磁干扰能力和较大电流冲击承受能力的产品结构和工艺技术; 具有高可靠性、多种金属组合、低 VF 值、高耐压、高结温的产品结构和工艺技术; 耐高绝缘电压、低热组、高可靠性的封装技术; 夯实质量控制和管理, 实现较高的芯片合格率和制造成本的优势。

### (2) 产品矩阵中长期定位与规划:

1) 250A/2600V 以下的“方片式”单、双向晶闸管塑封器件;

- 2) 半导体防护器件、功率稳压管系列器件、功率集成式防护器件；
- 3) 高端整流器件和 FRD；
- 4) 模块与组件（可控硅模组、整流模组、混合模组、MOSFET 模组、IGBT 模组、交直流固态继电器等）；
- 5) 小型化、薄型化、贴片式、低阻抗、高功率密度的先进封装工艺技术；
- 6) 平面技术的小信号器件；
- 7) 功率 MOSFET 器件；
- 8) 光电耦合器件；
- 9) IGBT 芯片的开发；
- 10) 碳化硅、氮化镓器件的开发和推广；
- 11) 功率 IC 的研究与开发；
- 12) 择机符合产业发展的资源整合（包括上下游）。

### **（3）知识产权提升和保护品牌战略：**

1) 进一步强化企业的知识产权意识体系、开发（创新）体系、知识产权运用体系、知识产权管理体系、知识产权防护体系，将知识产权思维贯穿到企业发展和企业运营的全过程中。

2) 专利：建立专利数据库，实时掌握竞争对手专利状态，“创新性技术包括新机理技术等先申请、后开发”，保护企业的专有技术；建立专利管理机制、专利奖励机制。每年取得 $\geq 3$  件发明专利授权、 $\geq 6$  件实用新型专利授权，以业务板块为单位的“产学研”项目每年不少于 1 项等。

3) 商业秘密：通过教育、培训等多种方式强化企业领导和员工的商业秘密意识；制定企业商业秘密保护方案和规章制度；明确商业秘密内容和等级；与员工签订商业秘密协议；建立网络环境下的商业秘密保护制度和措施。

4) 商标：制定和规范企业商标管理制度，统一化商标使用；配合市场拓展目标，提前注册国际商标；提高产品宣传中的商标显著度。

### **（4）人才发展规划：**

1) 加强人才梯队建设，培养一大批专业型基层优秀员工队伍。辅助各类激励政策，鼓励员工拓展技能的广度与深度，理论与实践结合并进，高效率高产出一体化，促进人才专业化多元化，进一步夯实人才核心竞争力。

2) 从优秀员工中选拔管理人才，根据岗位重点定向培养，逐步建立一支充足的高素质基层管理队伍和 中层管理后备力量。

3) 高质量引进、选拔和培养一批事业心强、一专多能的复合型复合型技术和管理人才（包括资本运作人才），打造核心高效团队，进一步增添企业活力，与企业共生共赢共长。

4) 弘扬“捷捷”理念和文化，打造优秀团队，着力通过平台、品牌双引擎驱动，积极引进和培养一批公平公正、事业心强、团队意识强、综合能力高、与本企业的发展和管理相匹配的杰出中高层管理队伍，和企业共同发展，利益共享。

### （三）公司的风险因素及应对措施

1、人力资源风险。公司当前正处于转型升级、跨越发展的关键时期，产品相对单一，对 MOSFET 和 IGBT 及第三代半导体等产品开发的人才储备不足，尤其是产品应用和项目管理人员缺口较大，短期内仍将给公司重点业务和产品的研究开发带来一定的不利影响。

对此，公司将进一步加强 MOS 事业部 VD MOS、SJ MOS 等以及捷捷上海 SGT MOS、先进 TVS、先进整流器件等产品持续研发工作，捷捷深圳产品应用推进等，并积极开展与科研院所等机构的长期技术合作，扎实开展研发工作，增强公司核心竞争力。公司将不断建立健全员工的激励机制，积极推进股权激励，逐步完善专业技术人才与产品应用专业人才的战略储备体系，努力降低人才短缺对公司未来发展的制约。

2、市场竞争加剧的风险。国际知名大型半导体公司占据了我国半导体市场 70%左右的份额，我国本土功率半导体分立器件生产企业众多，但主要集中在封装产品代工层面，与国际技术水平有较大差距。公司具备功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售一体化的业务体系，主要竞争对手为国际知名大型半导体公司，随着公司销售规模的扩大，公司与国际大型半导体公司形成日益激烈的市场竞争关系，加剧了公司在市场上的竞争风险。

对此，公司一直致力于通过加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场以及关键指标的可靠性等措施以全方位地增强核心竞争力，丰富现有产品结构，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，不断调整产品结构，加快推出新产品，降低制造成本，确保公司在行业内的竞争优势。

3、产品结构单一风险。公司主营产品为功率半导体分立器件，其中晶闸管系列产品 2019 年占公司营业收入的比例在 49%以上，公司存在对晶闸管产品依赖较大的风险。晶闸管仅为功率半导体分立器件众多类别之一，如果公司未来不能够保持研发优势，无法及时提升现有产品的生产工艺，并逐步向全控型功率半导体分立器件领域延伸，现有单一晶闸管产品将面临市场份额下降和品牌知名度降低的风险，公司经营业绩将受到较大影响。

对此，公司巩固现有晶闸管系列产品细分领域国内龙头地位，继续发挥自主定价权和产品的可靠性与成本优势，保持定制化生产与个性服务的特质，进一步提升进口替代空间与中高端应用领域，保持可持续发展的市场份额。

4、资产折旧摊销增加的风险。随着公司首发募投项目与定增新建项目投入使用或逐步投入使用，固定资产规模相应增加，资产折旧摊销随之加大，若不能及时释放产能产生效益，将对公司经营业务产生不



利影响。

为此，公司将结合各个项目实施进度，提前合理布局，加快产能释放，提升产能利用率及产品良率，加大市场拓展力度，促使项目及时产生效益，努力降低由此带来的经营风险。

5、重点研发项目进展不及预期的风险。近年来，公司一直致力于产业链的拓宽和产品的转型升级，并以重点研发项目为牵引，加大研发投入力度。由于国外先进半导体制造商产品更具品牌效应与关键技术可靠性与稳定性，客户对于新产品的立项或论证（可替换）周期较长，公司可能会面临重点研发项目进展不及预期的风险。

对此，公司将继续深入推进研发体系改革，继续加强同中科院微电子研究所、西安电子科技大学、湖南大学、东南大学（无锡分校）等深层次“产学研”合作。重视研发项目过程监控与产业化进程，提升研发质量和核心可靠性指标等，保持与客户高效沟通，力争重大研发项目按节点完成并产生预期效果，发挥边际效应，缩短产业周期。

6、宏观经济波动风险。功率半导体分立器件制造行业是半导体行业的子行业，半导体行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性。公司产品主要应用于家用电器、开关等民用领域，无功补偿装置、无触点交流开关、固态继电器等工业领域，及 IT 产品、汽车电子、网络通讯的防雷击防静电保护领域，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，半导体行业的景气度也将随之受到影响，下游行业的波动和低迷会导致公司客户对成本的考量更加趋于谨慎，产品的销售价格和销售数量均会受到相应的不利因素影响而下降，毛利率也将随之降低，对公司盈利带来不利影响。

对此，紧紧抓住国际大环境和这次疫情等给半导体产业造成严重影响等机遇与挑战，公司将加大新产品研发投入、市场渠道优势、强化管理效率和精细化运营，同时，加大产品结构长级和定制化技术创新力度，不断生产出受市场欢迎的产品，提升市场份额与品牌影响力，实现公司盈利的可持续增长，以防范宏观经济波动风险给公司带来的不利影响。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

| 产品名称    | 营业收入           | 营业利润           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 功率半导体芯片 | 155,387,880.86 | 56,828,312.08  | 36.57% | 39.71%      | 3.74%       | -12.68%    |
| 功率半导体器件 | 503,531,498.61 | 236,780,894.60 | 47.02% | 20.17%      | 17.00%      | -1.28%     |

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

①2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)，要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

②2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》(财会【2019】16号)，与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

③财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》(财会【2017】9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》(财会【2017】14号)（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注10、金融工具。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为4,335,940.79元，其中盈余公积为311,245.40元、未分配利润为4,024,695.39元。相关调整对本公司母公司财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为3,112,453.98元，其中盈余公积为311,245.40元、未分配利润为2,801,208.58元。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、2019年12月2日，江苏捷捷微电子股份有限公司与上海芯马信息科技合伙企业（有限合伙）、南通捷成信息科技合伙企业（有限合伙）三方共同出资人民币2000万元，在上海临港新片区成立控股子公司“捷捷微电（上海）科技有限公司”。其中，捷捷微电出资人民币1800万元，占捷捷上海注册资本的90%；上海芯马出资人民币150万元，占捷捷上海注册资本的7.5%；南通捷成出资人民币50万元，占捷捷上海注册资本的2.5%。捷捷微电（上海）科技有限公司于2019年12月起纳入合并范围。

2、2019年12月18日，江苏捷捷微电子股份有限公司以自有资金1000万元人民币在中国深圳设立全资

子公司“捷捷微电（深圳）有限公司”，公司出资比例为100%。